

性能特点

- 频率范围：6~18 GHz
- 均衡量：6.0 dB
- 插入损耗：0.6dB@18GHz
- 输入/输出阻抗：50 Ω
- 芯片尺寸：0.725X0.65X0.1 mm
- 100%在片测试

产品介绍

ZXA6608 是一款均衡器芯片 (Die)，采购GaAs无源单片工艺。频率范围覆盖6~18GHz，均衡量6.0dB，输入/输出回波损耗25/24dB。该芯片输入输出无需隔离电容，工作时无需加电，主要用于改善增益平坦度。芯片采用了片上通孔金属化工艺，保证了良好的接地；芯片背面进行了金属化处理，适用于导电胶粘接或共晶烧结工艺。

电气性能参数 (TA = +25℃)

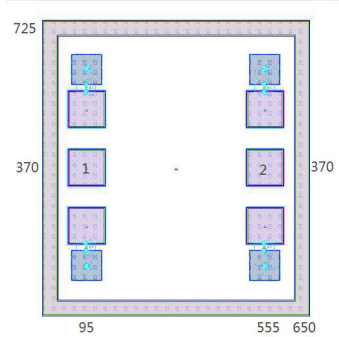
参数	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	6		18	GHz
均衡量		6.0		dB
输入回波损耗		25		dB
输出回波损耗		24		dB

使用限制参数

项目	数值
最高输入功率	+30 dBm
工作温度	-55 ~ +85 ℃
储存温度	-65 ~ +150 ℃

*超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏

键合点定义



说明

1. 单位： μm
2. 键合压点尺寸：100X100 μm
3. 芯片背面镀金接地
4. 外形尺寸公差： $\pm 50\mu\text{m}$



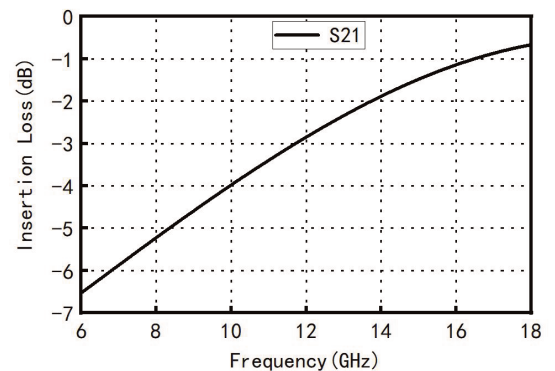
管脚	名称	描述
1	RF IN	RF端口，阻抗50 Ω
2	RF OUT	RF端口，阻抗50 Ω

装配说明：

1. 芯片厚度100 μm 。
2. 在净化环境装配使用，不要碰触表面，以免损伤芯片。
3. 输入输出使用2根金丝键合（直径25 μm ），键合线尽量短，不要长于400 μm 。
4. 用Au80Sn20 金锡烧结，温度不要超过300℃，烧结时间不要超过 30 秒。
5. 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电。
6. 干燥、氮气环境下保存。

典型测试曲线

损耗 VS 频率



输入/输出回波 VS 频率

